



高通推出骁龙 X Plus，日月光称先进封装供不应求 ——电子行业周报（2024.04.22-2024.04.26）

核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

算力芯片：高通推出全新骁龙 X Plus 平台，算力芯片产业加速发展。骁龙 X Plus 采用先进的高通 Oryon™ CPU，并旨在满足终端侧 AI 应用的需求，采用具有 45TOPS 算力的高通 Hexagon™ NPU，是全球最快的笔记本电脑 NPU。我们认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。

HBM：SK 海力士 12 层堆叠 HBM3E 开发或将于三季度完成，相关产业链或将受益。SK 海力士表示其 12 层堆叠（12Hi）HBM3E 内存开发有望三季度完成，2024 年客户主要聚焦 8Hi HBM3E 内存，将为 2025 年客户对 12Hi HBM3E 需求的全面增长做好准备。我们认为，各大存储厂持续积极推进 HBM 等尖端内存芯片生产，相关产业链有望持续受益。

先进封装：日月光称 AI 需求导致现阶段先进封装产能供不应求，先进封装产业链有望持续受益。日月光表示，AI 推升先进封装需求增长，现阶段产能供不应求，预期成长趋势可延续到 2025 年。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

存储芯片：希捷科技硬盘价格或将调涨，产业链有望持续受益。希捷科技称，将立即提高其硬盘产品的价格，调涨对象为新订单和超出先前承诺数量的需求。希捷预计，供应限制将持续，未来几个季度价格将继续上涨。我们认为，随着下游需求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。

市场行情回顾

本周（4.22-4.26），A 股申万电子指数上涨 5.21%，整体跑赢沪深 300 指数 4.01pct，跑赢创业板综指数 0.46pct。申万电子二级六大子板块涨跌幅由高到低分别为：元件(6.8%)、其他电子 II(6.73%)、消费电子(5.53%)、半导体(5.39%)、电子化学品 II(4.37%)、光学光电子(3.42%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势，海内外指数涨跌幅由高到低分别为：恒生科技(13.43%)、费城半导体(9.95%)、申万电子(5.21%)、道琼斯美国科技(5.12%)、纳斯达克(4.23%)、台湾电子(3.44%)。

投资建议

本周我们继续看好以 AI 为核心的算力芯片产业链、受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链、存储和先进封装为代表的半导体周期复苏主线。

算力芯片：英伟达业绩亮眼，算力需求攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

HBM：受益于英伟达发布 H200 算力芯片，产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等；

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

存储芯片：受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐东芯股份，建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等。

风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

增持(维持)

行业： 电子

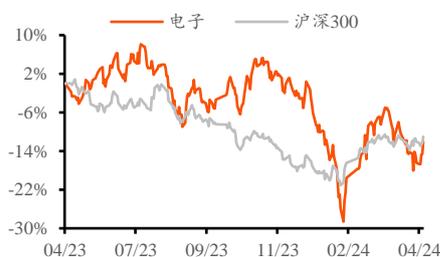
日期： 2024年04月29日

分析师： 陈宇哲

E-mail: chenyzhe@yongxings.com

SAC 编号: S1760523050001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

相关报告：

《台积电与 SK 海力士共推 HBM，Q2 原厂 SSD 或涨价》

——2024 年 04 月 23 日

《英特尔发布 AI 芯片 Gaudi 3，封装大厂布局 VFO》

——2024 年 04 月 16 日

《SK 海力士新建先进封装厂，大容量 SSD 价格上调》

——2024 年 04 月 09 日

正文目录

1. 本周核心观点及投资建议	3
2. 市场回顾	5
2.1. 板块表现	5
2.1. 个股表现	7
3. 行业新闻	8
4. 公司动态	10
5. 公司公告	12
6. 风险提示	13

图目录

图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况 (4.22-4.26)	5
图 2: A 股申万二级行业涨跌幅情况 (4.22-4.26)	5
图 3: A 股申万三级行业涨跌幅情况 (4.22-4.26)	6
图 4: 海内外指数涨跌幅情况 (4.22-4.26)	6

表目录

表 1: 电子行业 (申万) 个股本周涨跌幅前后 10 名 (4.22-4.26)	7
表 2: 电子行业本周重点公告 (4.22-4.26)	13

1. 本周核心观点及投资建议

核心观点:

算力芯片：高通推出全新骁龙 X Plus 平台，算力芯片产业加速发展。根据高通官网，高通技术公司推出骁龙®X Plus 平台，扩展领先的骁龙 X 系列平台产品组合。骁龙 X Plus 采用先进的高通 Oryon™ CPU，这一定制的集成 CPU 性能领先竞品高达 37%，同时功耗比竞品低 54%。骁龙 X Plus 还旨在满足终端侧 AI 应用的需求，采用具有 45TOPS 算力的高通 Hexagon™ NPU，是全球最快的笔记本电脑 NPU。我们认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。

HBM：SK 海力士 12 层堆叠 HBM3E 开发或将于三季度完成，相关产业链或将受益。根据 IT 之家援引 Viva100 报道，SK 海力士在一季度财报电话会议上表示其 12 层堆叠（12Hi）HBM3E 内存开发有望三季度完成。SK 海力士表示，2024 年客户主要聚焦 8Hi HBM3E 内存，SK 海力士将为 2025 年客户对 12Hi HBM3E 需求的全面增长做好准备。我们认为，各大存储厂持续积极推进 HBM 等尖端内存芯片生产，相关产业链有望持续受益。

先进封装：日月光称 AI 需求导致现阶段先进封装产能供不应求，先进封装产业链有望持续受益。根据科创板日报，半导体封测厂日月光于法说会上表示，AI 推升先进封装需求增长，现阶段产能供不应求，预期成长趋势可延续到 2025 年，该公司已取得更多先进封装订单。为应对客户需求，将调高 2024 年资本支出，扩充先进封装产能。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

存储芯片：希捷科技硬盘价格或将调涨，产业链有望持续受益。根据科创板日报，继西部数据宣布涨价之后，希捷科技（Seagate）日前也发出涨价函。希捷科技向客户发邮件称，将立即提高其硬盘产品的价格，调涨对象为新订单和超出先前承诺数量的需求。希捷指出，“需求仍在继续恢复，而我们的产能下降，限制了满足所有客户需求的能力，并导致交付周期延长。此外，我们的成本继续受到全球通胀压力影响。”其预计，供应限制将持续，未来几个季度价格将继续上涨。我们认为，随着下游需求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。

投资建议:

本周我们继续看好以 AI 为核心的算力芯片产业链、受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链、存储和先进封装为代表的半导体周期复苏主线。
算力芯片：英伟达业绩亮眼，算力需求攀升，有望带动上游算力芯片需求

增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

HBM：受益于英伟达发布 H200 算力芯片，产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等。

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

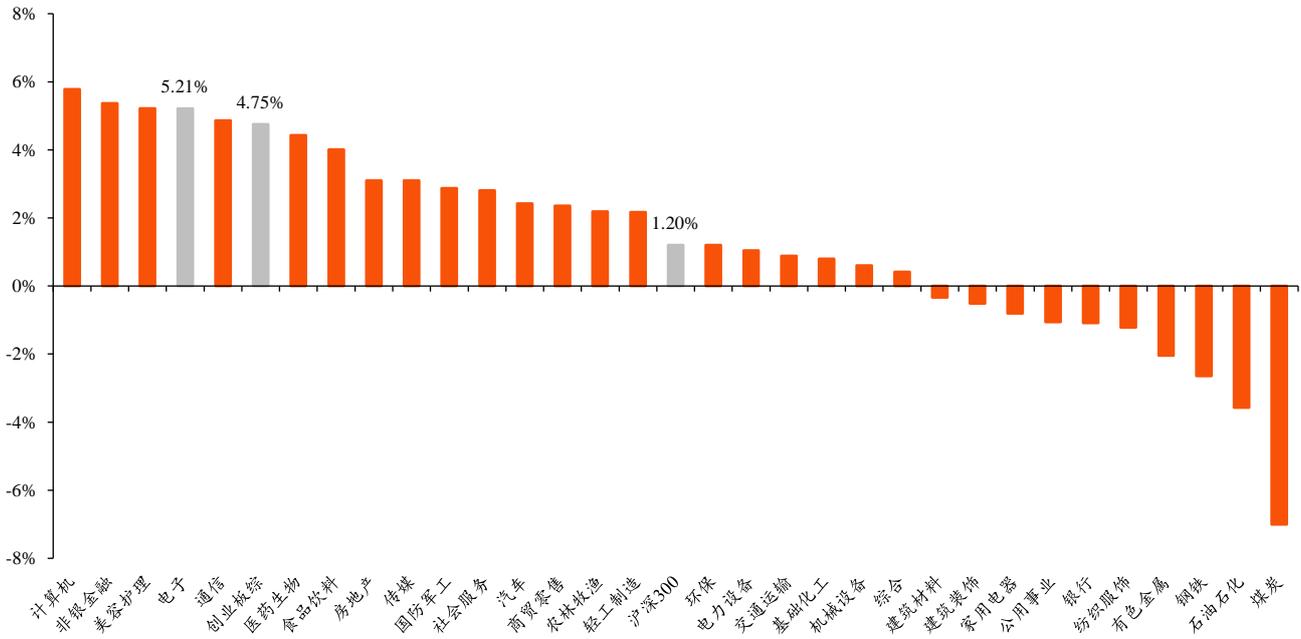
存储芯片：受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐东芯股份，建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等。

2. 市场回顾

2.1. 板块表现

本周（4.22-4.26），A股申万电子指数上涨5.21%，板块整体跑赢沪深300指数4.01pct，跑赢创业板综指数0.46pct。在申万31个一级子行业中，电子板块周涨跌幅排名为第4位。

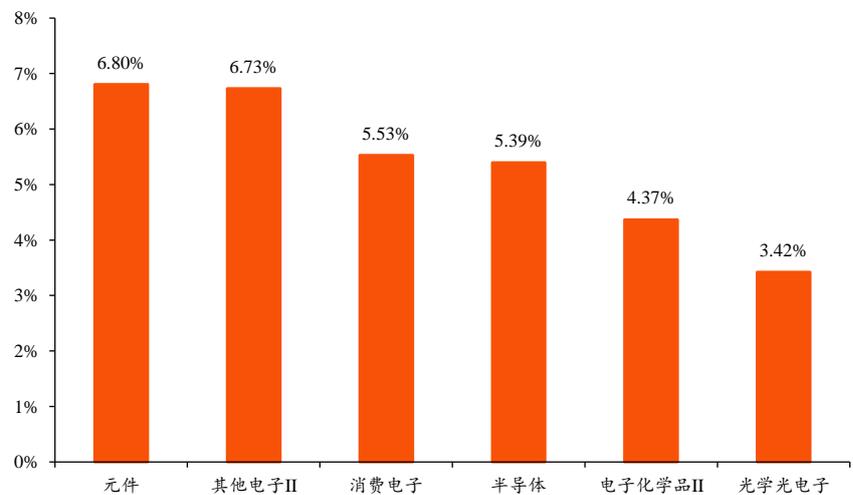
图1:A股申万一级行业涨跌幅情况（4.22-4.26）



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（4.22-4.26）申万电子二级行业中，元件板块上涨6.8%，表现较好；光学光电子板块上涨3.42%，表现较差。电子二级行业涨跌幅由高到低分别为：元件(6.8%)、其他电子 II(6.73%)、消费电子(5.53%)、半导体(5.39%)、电子化学品 II(4.37%)、光学光电子(3.42%)。

图2:A股申万二级行业涨跌幅情况（4.22-4.26）



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（4.22-4.26）申万电子三级行业中，模拟芯片设计板块上涨8.71%，表现较好；品牌消费电子板块下跌5.6%，表现较差。表现靠前的板块分别为：模拟芯片设计(8.71%)、印制电路板(8.38%)、消费电子零部件及组装(7.32%)。表现靠后的板块分别为：品牌消费电子(-5.6%)、面板(2.32%)、分立器件(2.65%)。

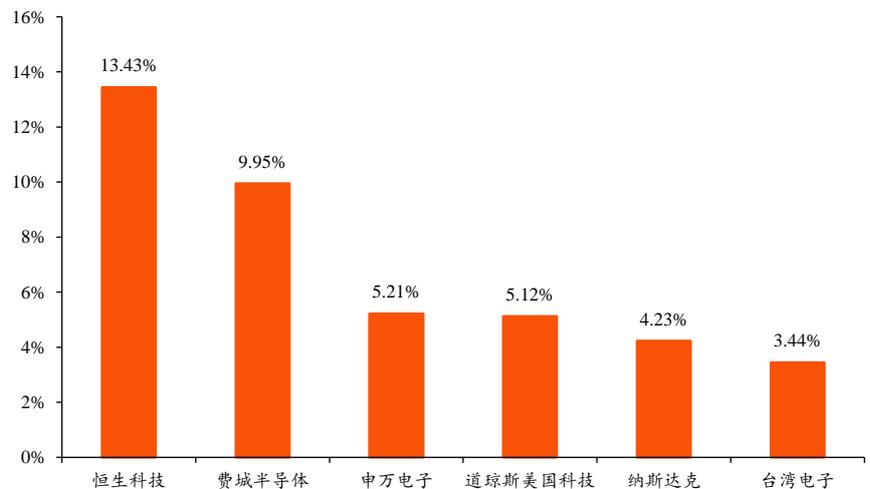
图3:A股申万三级行业涨跌幅情况（4.22-4.26）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势。本周（4.22-4.26），海内外指数涨跌幅由高到低分别为：恒生科技(13.43%)、费城半导体(9.95%)、申万电子(5.21%)、道琼斯美国科技(5.12%)、纳斯达克(4.23%)、台湾电子(3.44%)。

图4:海内外指数涨跌幅情况（4.22-4.26）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

2.1. 个股表现

本周（4.22-4.26）个股涨跌幅前十位分别为：胜蓝股份（+31.13%）、国芯科技（+28.61%）、*ST 长方（+23.93%）、腾景科技（+21.38%）、雅创电子（+20.41%）、超频三（+20.27%）、南亚新材（+19.61%）、神工股份（+18.66%）、晶丰明源（+18.38%）、纳芯微（+18.21%）。个股涨跌幅后十位分别为：*ST 碳元（-22.68%）、ST 恒久（-13.44%）、传音控股（-13.21%）、合力泰（-11.27%）、锦富技术（-9.8%）、凯华材料（-9.8%）、闻泰科技（-9.58%）、朗特智能（-9.41%）、ST 美讯（-9.32%）、贤丰控股（-8.94%）。

表1:电子行业（申万）个股本周涨跌幅前后 10 名（4.22-4.26）

周涨跌幅前 10 名			周涨跌幅后 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周跌幅(%)
300843.SZ	胜蓝股份	31.13%	603133.SH	*ST 碳元	-22.68%
688262.SH	国芯科技	28.61%	002808.SZ	ST 恒久	-13.44%
300301.SZ	*ST 长方	23.93%	688036.SH	传音控股	-13.21%
688195.SH	腾景科技	21.38%	002217.SZ	合力泰	-11.27%
301099.SZ	雅创电子	20.41%	300128.SZ	锦富技术	-9.80%
300647.SZ	超频三	20.27%	831526.BJ	凯华材料	-9.80%
688519.SH	南亚新材	19.61%	600745.SH	闻泰科技	-9.58%
688233.SH	神工股份	18.66%	300916.SZ	朗特智能	-9.41%
688368.SH	晶丰明源	18.38%	600898.SH	ST 美讯	-9.32%
688052.SH	纳芯微	18.21%	002141.SZ	贤丰控股	-8.94%

资料来源：Wind，甬兴证券研究所

3. 行业新闻

SK 海力士 HBM4 内存基础裸片有望采用台积电 7nm 制程

4月23日消息，根据IT之家援引韩媒The Elec，预测SK海力士将在HBM4内存的基础裸片（Base Die）部分采用台积电7nm制程。HBM内存的基础裸片是DRAM堆叠的底座，同时也作为控制器负责同处理器进行通信。SK海力士上周同台积电签署了HBM内存合作谅解备忘录，双方的首个合作重点就是HBM基础逻辑芯片的性能改善。SK海力士此前在HBM产品中采用存储半导体工艺制造基础裸片；而在HBM4中，台积电将采用先进逻辑工艺为SK海力士代工，以实现更丰富的功能和更加优异的功效，有助于满足客户对定制化HBM的需求。SK海力士目标到2026年实现HBM4内存投产。

资料来源：(IT之家)

希捷科技硬盘价格或将调涨

4月23日消息，根据科创板日报，继西部数据宣布涨价之后，希捷科技（Seagate）日前也发出涨价函。希捷科技向客户发邮件称，将立即提高其硬盘产品的价格，调涨对象为新订单和超出先前承诺数量的需求。希捷指出，“需求仍在继续恢复，而我们的产能下降，限制了满足所有客户需求的能力，并导致交付周期延长。此外，我们的成本继续受到全球通胀压力影响。”其预计，供应限制将持续，未来几个季度价格将继续上涨。

资料来源：(科创板日报)

软银将斥资近10亿美元布局算力基建，目标开发万亿参数大模型

4月23日消息，根据财联社，日本软银集团将在今明两年投资1500亿日元（约合9.6亿美元），为其计算设施提供开发“世界级”生成式人工智能所需的数字运算能力。2023年，软银宣布投资约200亿日元开发基于日语文本的生成式人工智能，预计在2024财年内完成一个3900亿参数的大语言模型（LLM）的开发，并计划最快在2025年开始开发1万亿参数的高性能模型。为了提供训练模型所需的算力，软银在今明两年新增了1500亿日元的投资支出，将从英伟达处采购图形处理单元（GPU）。在这笔冠绝日本公司的投资完成后，软银的算力实力也很可能在日本名列前茅。

资料来源：(财联社)

三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E 12H供货协议

4月24日消息，根据IT之家，根据韩媒Bridge Economy报道，三星和AMD公司签署了价值4万亿韩元的HBM3E供货合同。三星和AMD签署的这份合同中，AMD采购三星的HBM，而作为交换三星会采购AMD的AI加速卡，但具体换购数量目前尚不清楚。三星日前表示将于2024年

上半年量产 HBM3E 12H 内存，而 AMD 预估将会在 2024 年下半年开始量产相关的 AI 加速卡。三星 HBM3E 12H 支持全天候最高带宽达 1280GB/s，产品容量也达到了 36GB。相比三星 8 层堆叠的 HBM3 8H，HBM3E 12H 在带宽和容量上提升超过 50%。HBM3E 12H 采用了热压非导电薄膜（TCNCF）技术，使得 12 层和 8 层堆叠产品的高度保持一致，以满足当前 HBM 封装的要求。因为行业正在寻找缓解薄片带来的芯片弯曲问题，这项技术将在更高的堆叠中带来更多益处。三星一直在努力降低其非导电薄膜（NCF）材料的厚度，并实现芯片之间的间隙最小化至 7 微米（ μm ），同时消除了层与层之间的空隙。这些努力使其 HBM3E 12H 产品的垂直密度比其 HBM3 8H 产品提高了 20% 以上。

资料来源：(IT 之家)

SK 海力士：12 层堆叠 HBM3E 开发三季度完成，下半年整体内存供应可能面临不足

4 月 25 日消息，根据 IT 之家援引 Viva100 报道，SK 海力士在一季度财报电话会议上表示其 12 层堆叠（12Hi）HBM3E 内存开发有望三季度完成，而下半年整体内存供应可能面临不足。目前三星电子已发布其 12Hi HBM3E 产品，该内存单堆栈容量达 36GB，目前已开始向客户出样，预计下半年大规模量产。SK 海力士表示，2024 年客户主要聚焦 8Hi HBM3E 内存，SK 海力士将为 2025 年客户对 12Hi HBM3E 需求的全面增长做好准备。SK 海力士称，其将优先确保拥有更高附加值且需求能见度更高的 HBM 内存供应；HBM 内存芯片尺寸又是常规 DRAM 的两倍。些因素会相对挤压常规 DRAM 的晶圆投片量，预计下半年产能将受到限制。SK 海力士预估，如果下半年 PC 和智能手机需求复苏导致现有库存耗尽，内存市场将面临紧张局势。

资料来源：(IT 之家)

日月光：AI 需求导致现阶段先进封装产能供不应求，计划扩产

4 月 26 日消息，根据科创板日报，半导体封测厂日月光于法说会上表示，AI 动能爆发，推升先进封装需求大增，现阶段产能供不应求，预期成长趋势可延续到 2025 年，该公司已取得更多先进封装订单。为应对客户需求，将调高 2024 年资本支出，扩充先进封装产能。

资料来源：(科创板日报)

高通推出全新骁龙 X Plus 平台

4 月 24 日消息，根据高通官网，高通技术公司推出骁龙®X Plus 平台，扩展领先的骁龙 X 系列平台产品组合。骁龙 X Plus 采用先进的高通 Oryon™ CPU，这一定制的集成 CPU 性能领先竞品高达 37%，同时功耗比

竞品低 54%。显著提升的 CPU 性能将树立移动计算新标杆，助力用户更高效地完成任务。骁龙 X Plus 还旨在满足终端侧 AI 应用的需求，采用具有 45TOPS 算力的高通 Hexagon™ NPU，是全球最快的笔记本电脑 NPU。该平台是计算创新领域的又一个重大突破，将有望为 PC 行业带来新的变革。

资料来源：(高通官网)

4. 公司动态

【江波龙】公司新增 OPPO 为代表的新的大客户

4 月 23 日消息，江波龙在投资者互动平台表示，公司一季度营业收入 44.53 亿元，同比增长 200.54%，随着公司整体销售规模的不断增长，与之

匹配的公司存货储备也随之增加。与此同时，公司新增 OPPO 为代表的新的大客户，大客户对公司的产品持续供应能力有较高的要求，公司相应增加备货。此外，从上游原厂到分析机构均认为存储晶圆的价格在未来一段时间内将保持上涨的态势，公司存货的备货策略也会与下行周期有所差异。

资料来源：（投资者互动平台）

【甬矽电子】公司新增产线 Bumping/WLCSP

4月22日消息，甬矽电子在投资者互动平台表示，公司不同产品产能均有所扩充。具体而言，Bumping/WLCSP 是新产线，全部为新增产能；同时，原有的 SiP 类产品/QFN 类产品的市场需求持续回暖，包括应用于 PA 领域的模组类 SiP 封装、双圈 QFN 等新的需求也在增加，公司将根据市场情况在原有的基础上继续增加产能。公司坚持中高端先进封装定位，持续加大研发投入，一方面，公司推进成熟产线的扩产，另一方面，积极布局先进封装和汽车电子领域，按市场需求稳步推进包括 Bumping、晶圆级封装、FC-BGA、汽车电子的 QFP 等新产品线布局。

资料来源：（投资者互动平台）

【捷捷微电】公司南通科技 8 寸线部分 SGT MOS 已经量产

4月22日消息，捷捷微电在投资者互动平台表示，南通科技 8 寸线部分 SGT MOS 已经量产，还有部分委外绍兴中芯集成电路制造股份有限公司代工。四月份以来，公司产品线的销售都有一定的增幅。

资料来源：（投资者互动平台）

【泰凌微】公司产品应用于汽车数字钥匙，已经实现量产并稳步增长

4月22日消息，泰凌微在投资者互动平台表示，公司产品应用于汽车数字钥匙，已经实现量产并稳步增长中。公司在无线电池管理系统方面也有布局，基于公司 Mesh 技术开发了低延时高可靠性的多节点互连方案，正在推广过程中。

资料来源：（投资者互动平台）

【晶升股份】公司的 CVD 产品即将进入客户验证阶段

4月25日消息，晶升股份在投资者互动平台表示，公司的 CVD 产品为碳化硅外延设备，目前即将进入客户验证阶段。

资料来源：（投资者互动平台）

5. 公司公告

表2:电子行业本周重点公告 (4.22-4.26)

日期	公司	公告类型	要闻
2024/04/22	沃尔核材	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润7亿元,同比增长13.97%;营业收入57.23亿元,同比增长7.16%;基本每股收益0.56元,同比增长14.29%
2024/04/22	闻泰科技	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润11.81亿元,同比减少19.0%;营业收入612.13亿元,同比增长5.4%;基本每股收益0.95元,同比减少18.8%
2024/04/22	联特科技	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润2648.27万元,同比减少76.61%;营业收入6.06亿元,同比减少26.55%;基本每股收益0.2042元,同比减少80.99%
2024/04/23	京仪装备	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润1.19亿元,同比增长30.75%;营业收入7.42亿元,同比增长11.84%;基本每股收益0.92元,同比增长27.78%
2024/04/23	麦捷科技	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润2.7亿元,同比增长35.07%;营业收入30.17亿元,同比减少4.28%;基本每股收益0.3152元,同比增长34.3%
2024/04/24	兴森科技	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润2.11亿元,同比减少59.82%;营业收入53.6亿元,同比增长0.11%;基本每股收益0.13元,同比减少60.61%
2024/04/24	华勤技术	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润27.07亿元,同比增长5.59%;营业收入853.38亿元,同比减少7.89%;基本每股收益3.969元,同比增长0.91%
2024/04/24	中科飞测	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润1.4亿元,同比增长1072.38%;营业收入8.91亿元,同比增长74.95%;基本每股收益0.49元,同比增长880.0%
2024/04/25	上海合晶	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润2.47亿元,同比减少32.35%;营业收入13.48亿元,同比减少13.38%;基本每股收益0.41元,同比减少32.79%
2024/04/25	中电港	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润2.37亿元,同比减少40.93%;营业收入345.04亿元,同比减少20.32%;基本每股收益0.3322元,同比减少52.74%
2024/04/26	雅克科技	年度报告	2023年度,公司整体营收较2023年增长11.24%,利润状况维持稳定,总体经营情况更加稳健。报告期内,公司实现营业收入473,777.32万元,与上年同期相比增长11.24%;实现营业利润和利润总额分别为75,828.01万元和73,941.53万元,分别比上年同期增长16%和13%;实现归属于上市公司股东的净利润为57,948.04万元,同比增长10.43%
2024/04/26	华海清科	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润7.24亿元,同比增长44.29%;营业收入25.08亿元,同比增长52.11%;基本每股收益4.55元,同比增长29.26%
2024/04/26	芯源微	年度报告	2023年归属于母公司所有者的净利润2.51亿元,同比增长25.21%;营业收入17.17亿元,同比增长23.98%;基本每股收益1.82元,同比减少19.82%

资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

6. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。